

Title (en)

Apparatus for punching a web-like or a sheet-like material and method for manufacturing a support plate

Title (de)

Vorrichtung zum Stanzen von bandförmigen und bogenförmigen Material und Verfahren zur Herstellung einer Trägerplatte

Title (fr)

Dispositif pour poinçonner un matériau en forme de bande ou feuille et procédé de fabrication d'une plaque de support

Publication

EP 0922545 A2 19990616 (DE)

Application

EP 98122343 A 19981125

Priority

DE 19754376 A 19971209

Abstract (en)

The machine for stamping cardboard has a platen area in which a strip steel section is overlaid on an adjustably mounted support plate. An opposing stamp plate carries a stamp etching on its surface opposing the platen area. The carrier plate (18) has a base plate (24) with at least one hard metal plate which is pressure stable and resistant to mechanical forces. The carrier plate can have two hard metal plates on both side of the base plate. The hard metal plates can be made of a corrosion resistant material.

Abstract (de)

Dargestellt und beschrieben ist eine Vorrichtung (10) zum Stanzen von bandförmigem und bogenförmigem Material, insbesondere Karton, mit einem sogenannten Tiegelbereich (11), in dem ein Bandstahlschnitt (17) gegenüberliegend einer auf einer Trägerplatte (18) fest bzw. verstellbar angeordneten, eine Stanzgravur tragenden Gegenstanzplatte (19) vorhanden ist, wobei die Trägerplatte (18) eine zum Bandstahlschnitt und eine zum Tiegelbereich gerichtete Fläche aufweist. Aufgabe der Erfindung ist es, eine neue Trägerplatte (18) zu schaffen, die eine prinzipiell größere Stanzzeit bei großer Genauigkeit aufweist. Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich dadurch, wonach die Trägerplatte (18) in eine Basisplatte (24) sowie mindestens eine an den o.g. Flächen angeordneten, druckstabilen und gegen mechanische Einwirkungen widerstandsfähigen Hartmetallplatte (25) aufgeteilt ist. <IMAGE>

IPC 1-7

B26D 7/20; **B26F 1/44**

IPC 8 full level

B26D 7/20 (2006.01); **B26F 1/44** (2006.01)

CPC (source: EP)

B26D 7/20 (2013.01); **B26F 1/44** (2013.01); **B26F 1/40** (2013.01); **B26F 2001/4463** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH ES FR GB IT LI NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0922545 A2 19990616; **EP 0922545 A3 20000906**; **EP 0922545 B1 20020403**; AT E215432 T1 20020415; DE 19754376 C1 19981224; ES 2175592 T3 20021116

DOCDB simple family (application)

EP 98122343 A 19981125; AT 98122343 T 19981125; DE 19754376 A 19971209; ES 98122343 T 19981125